

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2025 年 12 月 9 日-12 月 12 日)

投资者关系活动类别	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>专场机构交流会</div><div><input type="checkbox"/>其他 _____</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div></div>
参与单位名称及人员姓名	在线参与 2025 年第三季度业绩说明会的投资者 东方阿尔法 梁少文、东方阿尔法 吴秋松、趣时资产 冯珺、富国基金 杨栋、益恒投资 田黄达、中信保诚 王优草、国联基金 陈祖睿、瑞园投资 唐雷、安信基金 谭珏娜、富荣基金 郭梁良、富荣基金 李延峥、国联民生证券 方竞、国联民生证券 杨璐嘉、英大证券 周子桐
会议时间	2025 年 12 月 9 日 15：00-16：00 2025 年 12 月 12 日 14：00-16：00
会议地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> ） 佰维存储三楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司管理层 董办工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q1. 展望 2025 年第四季度及明年，是否有新业务或新产品能成为重要的利润增长点？</b></p> <p><b>A1:</b> 公司聚焦 AI 技术催生的产业机遇，不断开拓高毛利的创新业务。公司在 AI 端侧存储拥有较强的竞争力，能够通过自研主控芯片、固件算法与先进封测能力实现差异化竞争，并已构建完整的产品布局，覆盖 AI 手机、AI PC、AI 眼镜、具身智能等多场景，公司是业内率先抓住 AI 眼镜机遇的解决方案厂商。通过布局以上高毛利创新业务，公司能够充分分享行业爆发带来的增长红利。在产品方面，公司面向 AI 手机已推出 UFS、LPDDR5/5X、uMCP 等嵌入式存储产品，并已量产 12GB、16GB 等大容量 LPDDR5X 产品。在 PC 领域，AI PC 基于大模型的算力需求，对搭载大容量先进制程 DRAM 产品的需求增加，同时为了有效管理 PC 上运行的 AI 数据，也会增加对 NAND 产品的需求；公司面向 AI PC 已推出高端 DDR5 超频内存条、PCIe 5.0 SSD 等高性能存储产品；在智能可穿戴领域，公司 ePOP 系列产品目前已被 Google、Meta、小米、阿里、小天才、Rokid、雷鸟创新等知名企业应用于其智能手表、智能眼镜等智能穿戴设备上；在企业级领域，公司已推出 CXL 内存、PCIe SSD、SATA SSD 及 RDIMM 内存条等产品线，并获得服务器厂商、头部互联网厂商以及国内头部 OEM 厂商的核心供应商资质，公司将持续推动企业级业务的拓展；在智能汽车领域，公司已进入比亚迪、长安的供应链体系，并向头部车企大批量交付 LPDDR 和 eMMC 产品，公司将持续推动新产品导入验证，加速车规级产品导入更多主流车企及 Tier1 厂商。</p>

	<p><b>Q2. 国产自研 eMMC 主控 SP1800 已批量交付，UFS 主控 SP9300 预计 2025 年内投产，请问这两款主控芯片的良率水平如何？未来在手机、车规等领域的商业化落地计划，是否有明确的客户拓展和出货量目标？</b></p> <p><b>A2:</b> 公司首款主控芯片 SP1800 eMMC 5.1 实现多项国产突破，性能优异，实测关键指标性能和功耗满足客户需求，已批量生产。在智能穿戴应用方面，SP1800 在性能和功耗方面进行了优化，并可实现定制化调整，其解决方案受核心客户认可；在手机应用方面，SP1800 支持 TLC 及 QLC 颗粒，迎合手机存储 QLC 替代趋势；在车规应用方面，SP1800 提供端到端数据保护，适合车规宽温应用场景，其解决方案受核心客户认可。公司在芯片设计领域持续加大研发力度，专注于自研 LDPC 纠错算法、高性能架构以及低功耗技术的研发，致力于构建主控核心技术平台。基于该平台，公司积极推进 UFS 主控芯片等关键领域，围绕功耗、性能、可靠性等核心指标，努力打造行业领先的、具备高度竞争力的主控能力，为提升存储解决方案的核心竞争力提供坚实保障。</p> <p><b>Q3. 公司车规存储进入主流车厂供应链，且出货量持续攀升，行业 DDR5 技术正快速普及。想请问公司车规级 LPDDR、eMMC 产品在性能上是否已适配 DDR5 标准？针对智能驾驶对存储的高带宽需求，后续技术升级路线是怎样的？</b></p> <p><b>A3:</b> 公司的智能汽车存储解决方案包括车规级 LPDDR、eMMC、UFS 和存储卡，公司的车规级解决方案为自动驾驶、智能座舱及实时导航等先进智能汽车功能提供了支持，已通过数家国内领先汽车 OEM 厂商的严苛认证，并已成功实现大批量交付。凭借自研主控芯片与先进封装能力，公司的车规级解决方案能够提供端到端数据保护，并已通过 AEC-Q100 车规级电子组件认证。公司将持续推动新产品导入验证，构建起覆盖多场景的完整车载存储产品矩阵。</p> <p><b>Q4. 2024 年公司 AI 新兴端侧领域营收同比增长 294%，2025 年 AI 眼镜收入预增 500%，目前行业正处于 AI 驱动的超级周期，请问公司对 2026 年该领域营收增长目标是否有调整？公司对明年端侧应用的增长预期如何？</b></p> <p><b>A4:</b> 公司在 AI 端侧存储拥有较强的竞争力，能够通过自研主控芯片、固件算法与先进封测能力实现差异化竞争，并已构建完整的产品布局，覆盖 AI 手机、AI PC、AI 眼镜、具身智能等多场景，公司是业内率先抓住 AI 眼镜机遇的解决方案厂商。通过布局以上高毛利创新业务，公司能够充分分享行业爆发带来的增长红利。根据公司 2025 年第一季度报告，预计 2025 年公司面向 AI 眼镜产品收入有望同比增长超过 500%。</p> <p><b>Q5. 公司在技术创新和产业升级方面有哪些举措？</b></p> <p><b>A5:</b> 公司紧紧围绕半导体存储器产业链，布局存储解决方案研发、主控芯片设计、存储器封测/晶圆级先进封测和存储测试机等产业链关键环节。在存储解决方案研发方面，公司聚焦 AI 技术催生的产业机遇，不断开拓高毛利的创新业务，产品已覆盖 AI 手机、AI PC、AI 眼镜、具身智能等多场景。在主控芯片设计领域，公司持续加大研发力度，专注于自研 LDPC 纠错算法、高性能架构以及低功耗技术的研发，致力于构建主控核心技术平台。基于该平台，公司积极推进 UFS 主控芯片等关键领域，围绕功耗、性能、可靠性等核心指标，努力打造行业领先的、具备高度竞争力的主控能力，为提升存储解决方案的核心竞争力提供坚实保障。在先进封测领域，公司是业内最早布局研发封测一体化的企业。公司在</p>
--	--

	<p>现有技术基础上进一步布局晶圆级先进封测能力，不断提升技术壁垒，提升产业链价值占比和产品竞争力。</p> <p><b>Q6. 公司布局晶圆级先进封测的核心价值如何体现？</b></p> <p><b>A6:</b> 公司是业内最早布局研发封测一体化的企业，从 2010 年开始就自建封测能力，有十几年的积累沉淀，存储封测的技术能力达到国内领先、国际一流的水平。公司在现有技术基础上进一步布局晶圆级先进封测能力，不断提升技术壁垒。公司通过晶圆级先进封测制造项目构建晶圆级封装能力，一方面可以满足先进存储封装需求，为公司研发和生产先进存储产品构建技术基础，提供相关封装产能；另一方面可以与公司存储业务协同，为相关客户提供存储解决方案+晶圆级先进封测服务。公司坚持“研发封测一体化”的战略布局，持续增加产业链覆盖环节，发挥公司在自研主控、先进封测、测试设备等领域的优势，提升产业链价值占比和产品附加值，不断提升公司行业竞争力和盈利稳定性。</p> <p><b>Q7. 公司如何看待存储行业的发展趋势？</b></p> <p><b>A7:</b> 公司认为存储行业未来有三个发展趋势：一是在云、边、端三个方面的 AI 深度应用，AI 要求存储具有大容量和高带宽的特点，边缘、端侧更强调存储低延迟、高性能和小尺寸，因此需在芯片设计、先进封装、测试设备等多个技术领域适应 AI 时代，做出满足更大容量、更高性能、更低功耗、更小尺寸综合要求的产品，通过差异化的解决方案提升整体方案价值；得益于公司研发封测一体化布局，公司在主控芯片设计、解决方案研发和先进封测等领域的技术能力行业领先，可为 AI 端侧产品提供低功耗、高性能、小尺寸、大容量的存储解决方案。二是全球贸易摩擦使市场割裂，更加强调本地化交付能力，公司积极进行区域产能布局，在国内、巴西、印度、墨西哥等地布局，能够为公司带来新的商业机会。三是存储与先进封装深度整合，先进封装成为技术前进的主要方向。公司具备提供“存储+晶圆级先进封测”一站式综合解决方案的能力，顺应存储与计算整合的技术发展趋势，公司提供的综合解决方案的价值量相比单独的先进封测服务，具有显著的放大效应，可以在 AI 时代持续创造价值。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2025 年 12 月 9 日-12 月 12 日
<b>备注</b>	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。